

2008年3月期(第11期)

# 中間決算説明会

2007年11月19日

株式会社ビー・テクノロジー

本資料に記載されている業績見通しは、将来の予測であり、リスクや不確定要素を含んだものです。実際の業績は、経済情勢をはじめ様々な要因により、見通しと異なる結果となりうることをご承知おき下さい。

# 2008年3月期中間決算概要

# 連結業績ハイライト(前年同期比)

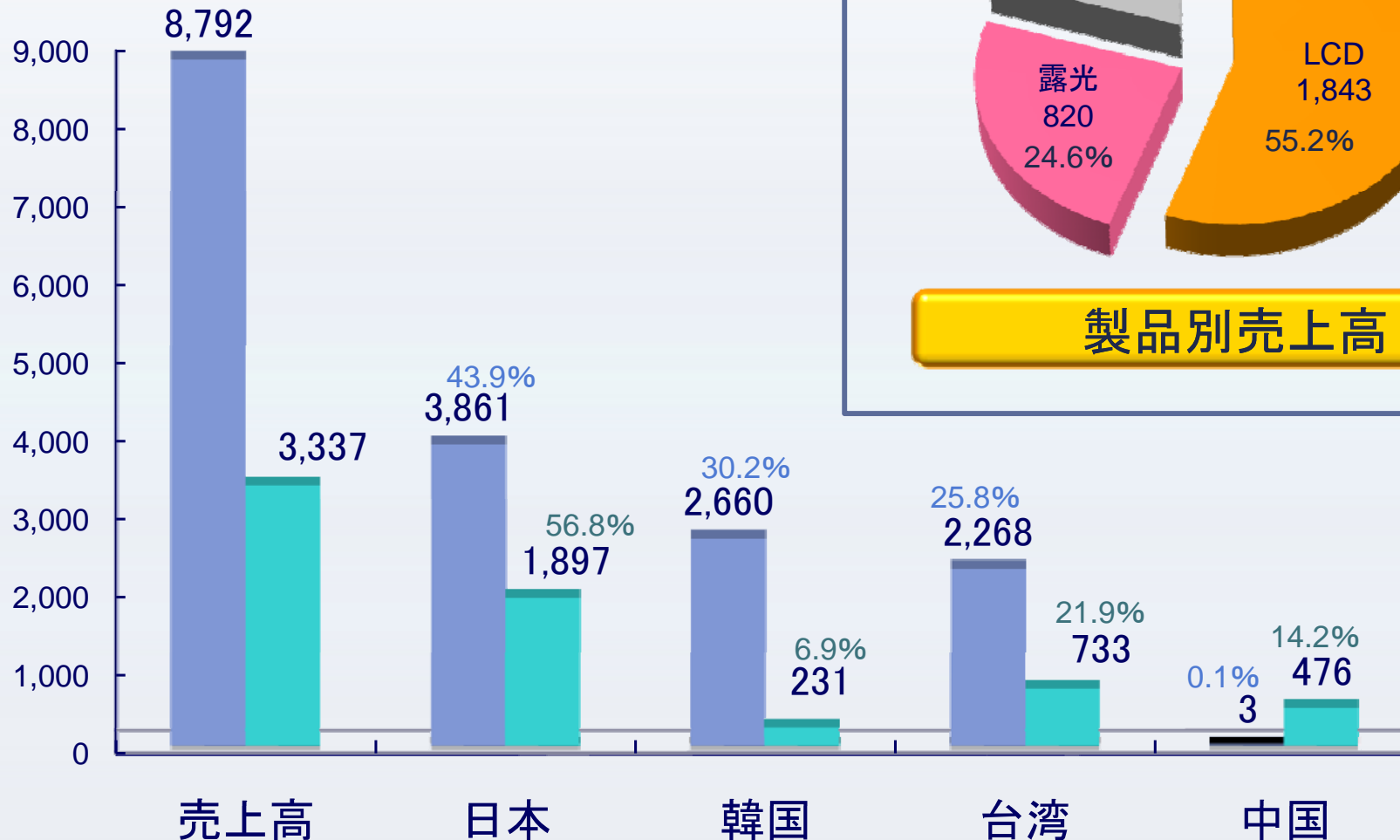


(金額:百万円)

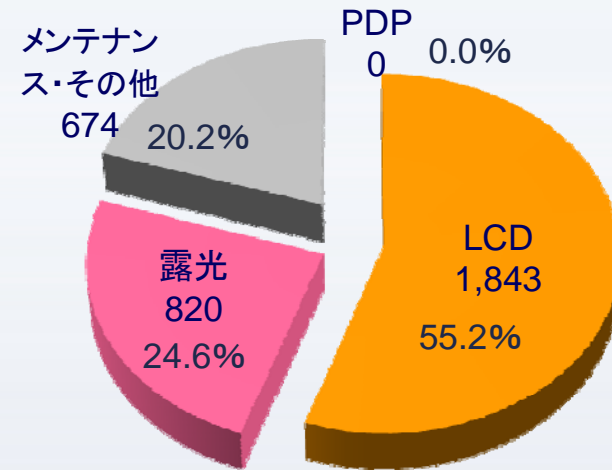
	前中間期		当中間期		増減率
	金額	構成比	金額	構成比	
売上高	8,792	100.0%	3,337	100.0%	▲62.0%
売上総利益	1,820	20.7%	461	13.8%	▲74.7 %
営業利益	754	8.6%	▲ 396	▲ 11.9%	▲152.5 %
経常利益	739	8.4%	▲ 420	▲ 12.6%	▲156.8 %
当期純利益	459	5.2%	▲ 298	▲ 8.9%	▲164.9 %

# 地域別/製品別連結売上高(前年同期比)

## 地域別売上高



(金額:百万円)



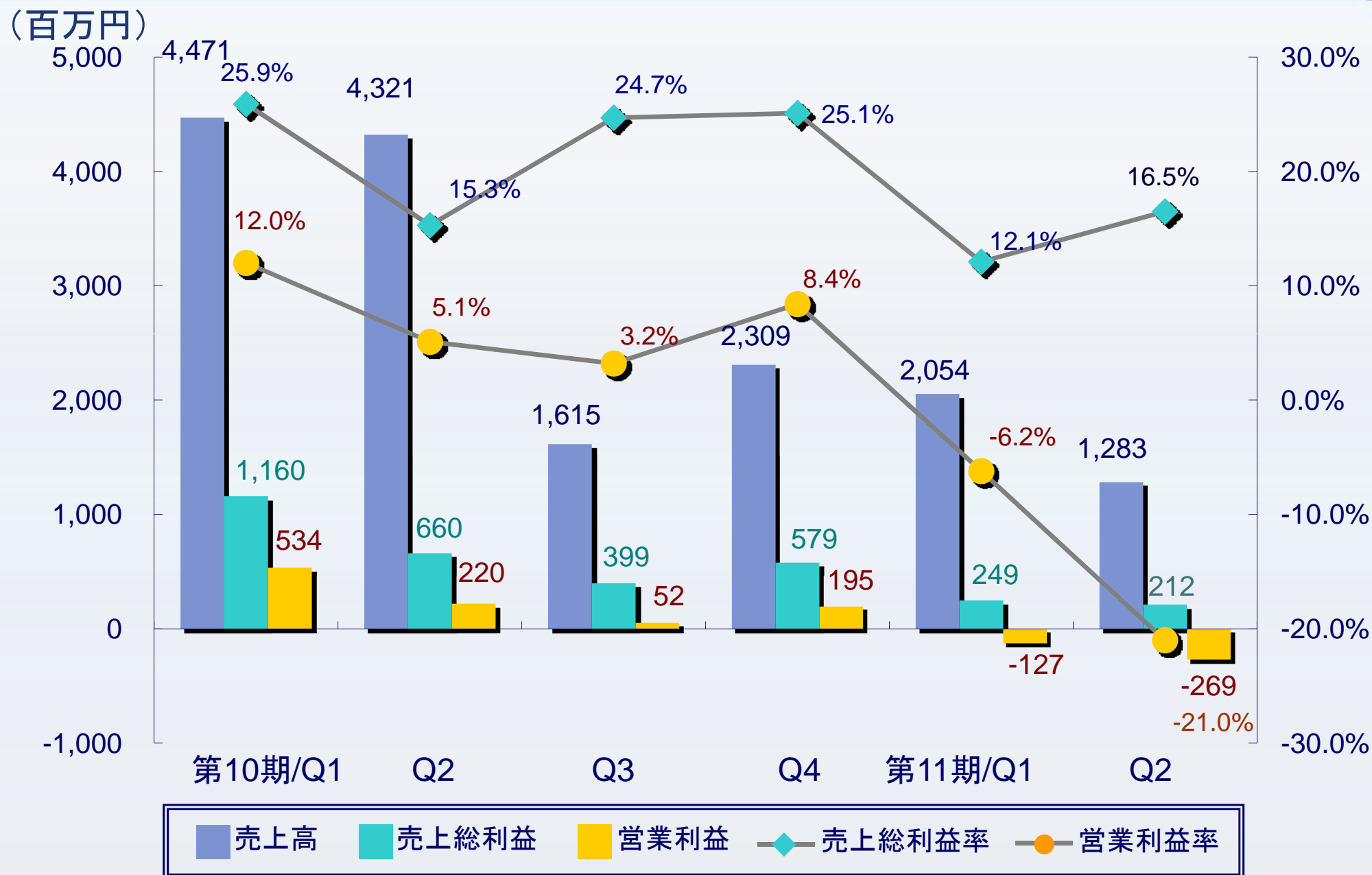
## 製品別売上高

# 装置タイプ別連結売上高（前年同期比）

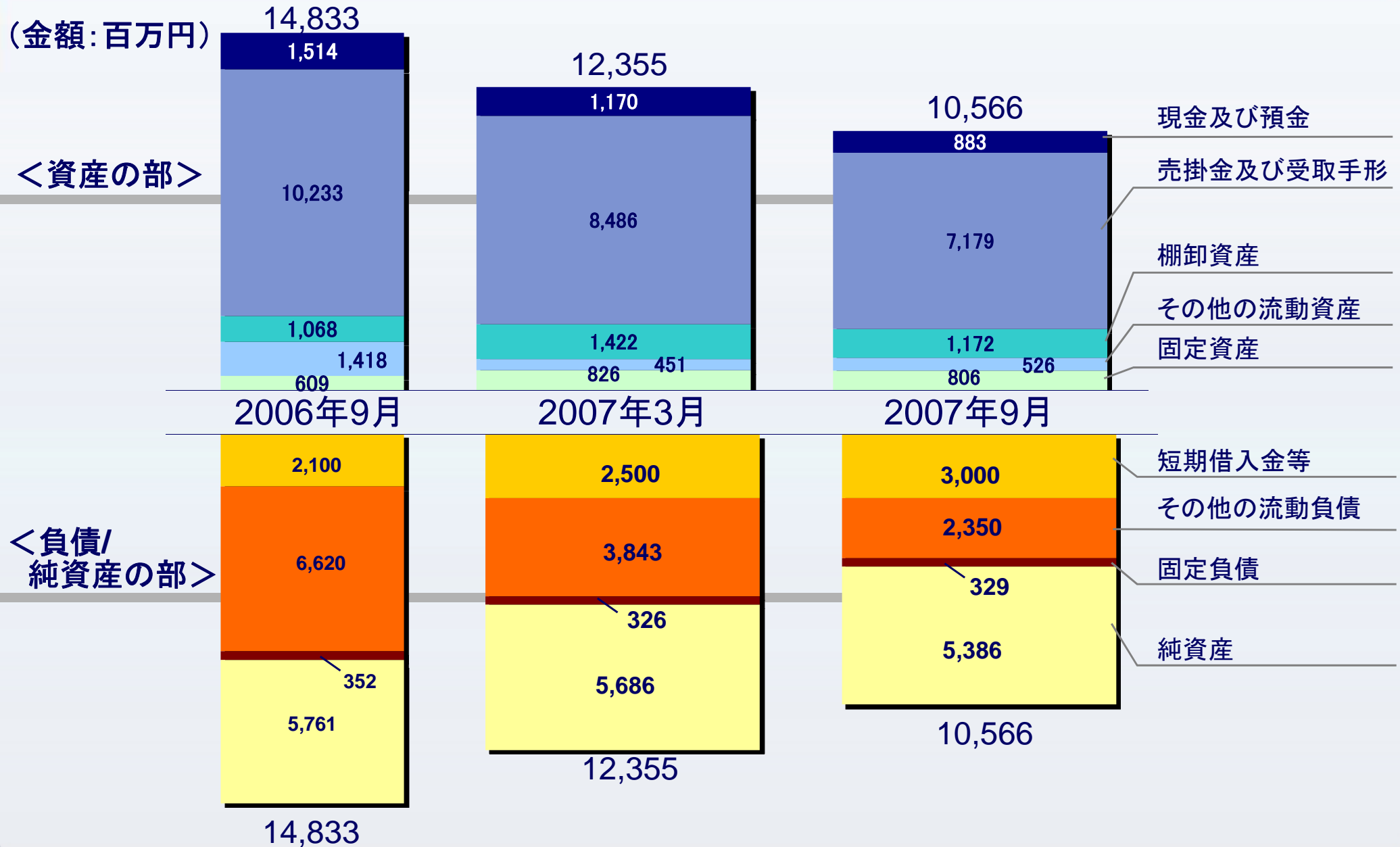


前中間期	8,792	1,228	1,802	3,544	1,572	646
当中間期	3,337	497	700	692	820	628

# 四半期毎連結売上高・利益推移



# 連結貸借対照表



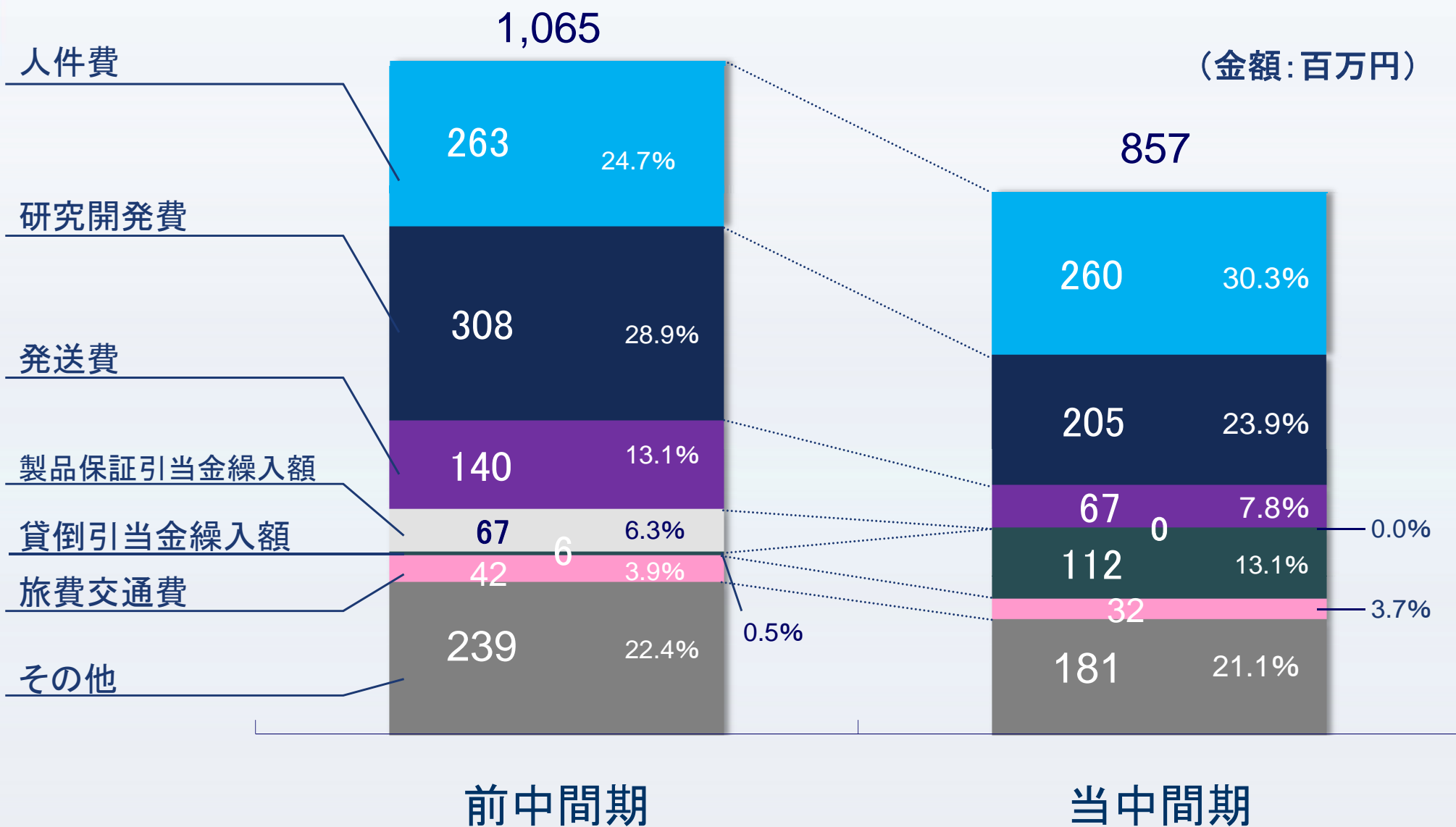
# 連結キャッシュフロー



		(金額:百万円)		
		06/09	07/03	07/09
期首現金及び現金同等物残高		2,058	2,058	1,170
営業活動による キャッシュ・フロー	税金等調整前純利益	734	942	▲ 379
	売上債権 (増加▲)	▲ 1,668	69	1,306
	在庫 (増加▲)	417	65	249
	仕入債務 (減少▲)	1,752	▲ 911	▲ 808
	その他	▲ 1,217	▲ 733	▲ 388
		11	▲ 574	▲ 20
投資活動によるキャッシュ・フロー		▲ 138	▲ 239	▲ 554
財務活動による キャッシュ・フロー	借入	10,830	29,230	17,200
	返済	▲ 11,255	▲ 29,280	▲ 17,225
	その他	▲ 2	▲ 35	▲ 2
		▲ 428	▲ 85	▲ 26
現金及び現金同等物に係わる換算差額		10	12	0
現金及び現金同等物の増減額		▲ 544	▲ 887	▲ 601
期末現金及び現金同等物残高		1,514	1,170	569



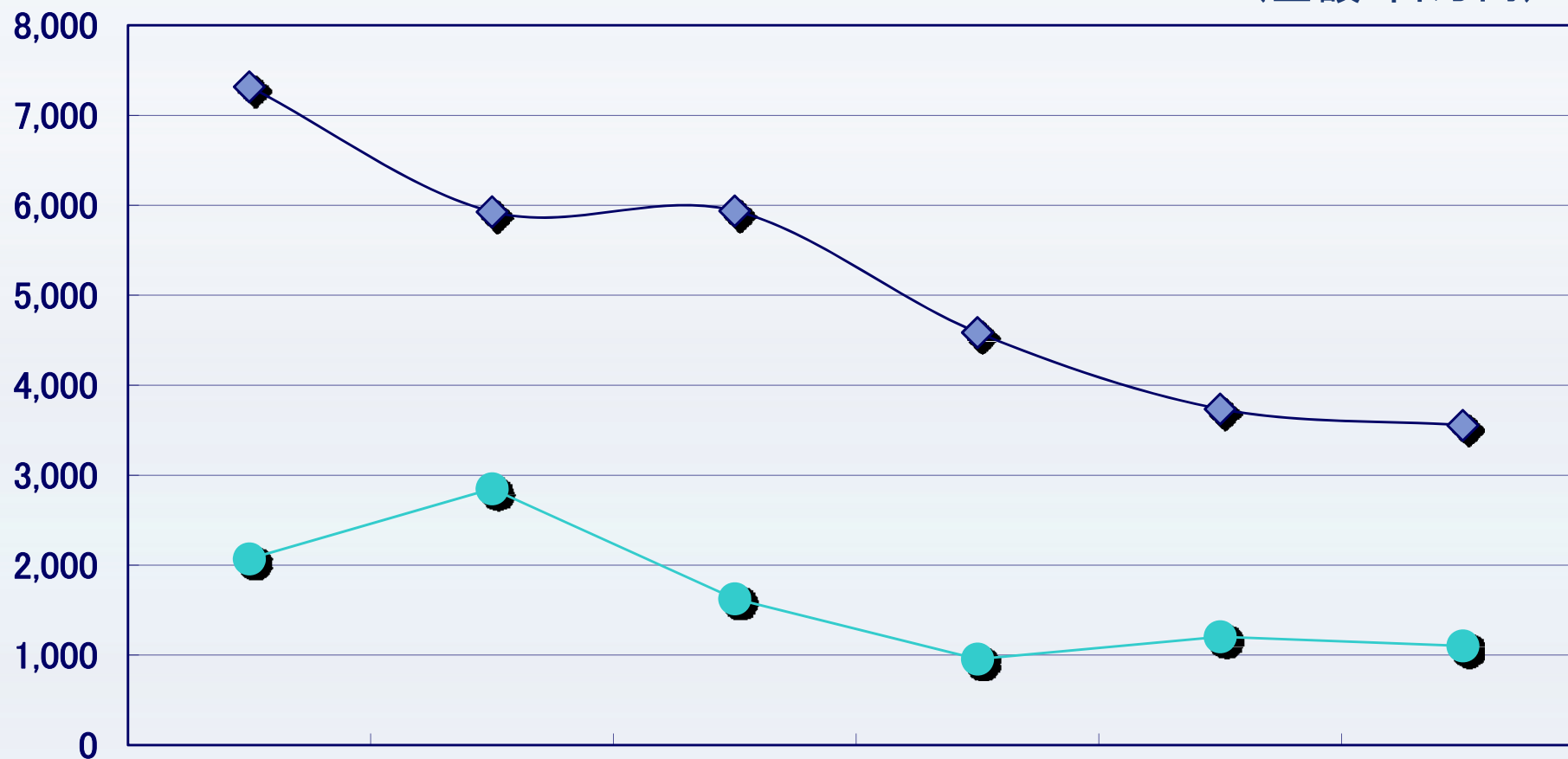
# 主な販売費及び一般管理費



# 受注残・受注額推移



(金額:百万円)



10期Q1

Q2

Q3

Q4

11期Q1

Q2

受注残

7,317

5,927

5,937

4,585

3,735

3,554

受注額

2,070

2,848

1,626

956

1,204

1,103

# 通期業績見通しと 今後の方針について

# 通期連結業績予想



(金額:百万円)

	前期実績		今期予想				増減率
			上期実績		通期予想		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
売上高	12,717	100.0%	3,337	100%	6,550	100.0%	▲48.5%
営業利益	1,001	7.9%	▲ 396	▲ 11.9%	▲ 650	▲ 9.9%	▲164.9%
経常利益	948	7.5%	▲ 420	▲ 12.6%	▲ 670	▲ 10.2%	▲170.7%
当期純利益	415	3.3%	▲ 298	▲ 8.9%	▲ 480	▲ 7.3%	▲215.6%

# 国家プロジェクトへの参加 ー概要ー

## 「次世代大型低消費電力液晶ディスプレイ基盤技術開発プロジェクト」助成金交付対象企業に選定

### プロジェクト概要

・主催： 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

・期間： 平成19年度～23年度(5年間)

・概要： ①装置技術及びプロセス技術の開発

②画像表示技術の開発

③高効率部材の開発

これらの開発により、40型以上のフルハイビジョン液晶での消費電力半減を目指す。

・対象企業：	・シャープ	・ソニー	・日立ディスプレイズ
	・東京エレクトロン	・芝浦メカトロニクス	・バイ・テクノロジー

# 国家プロジェクトへの参加 —各社の研究項目—

NEDO

助成(助成率1/2)

シャープ株式会社

- ① 装置技術及びプロセス技術の開発
- ② 画像表示技術の開発
- ③ 高効率部材の開発

株式会社日立  
ディスプレイズ

- ② 画像表示技術の開発
- ③ 高効率部材の開発

ソニー株式会社

- ① 装置技術及びプロセス技術の開発
- ② 画像表示技術の開発
- ③ 高効率部材の開発

東京エレクトロン  
株式会社

- ① 装置技術及びプロセス技術の開発

芝浦メカトロニクス  
株式会社

- ① 装置技術及びプロセス技術の開発

株式会社  
バイ・テクノロジー

- ① 装置技術及びプロセス技術の開発

<共同研究>

東北大学・成蹊大学・東京工業大学・  
東京大学・東京工芸大学・静岡大学

## ① 装置技術及びプロセス技術の開発

### バイ・テクノロジー参加分野

- 新規装置技術の開発  
ディスプレイの大型化・高精細化に向けて、生産能力の向上とプロセスエネルギーの低減を狙った新規装置技術の開発を行う。また、大画面用高性能TFTを作製するための新規装置技術開発を行い、ディスプレイの低消費電力化を図る。
- 達成目標  
大型の低消費電力パネル実現に必要な大画面用高性能TFT技術を確立するため、成膜装置技術を開発する。また、高精細大型パネルに対応した高速ウェット装置や露光装置および検査装置等の基盤技術を開発し、プロセスエネルギー低減と高生産性を狙う。